



2015年3月期

# 中間決算説明会

(第2四半期累計)

2014年11月25日

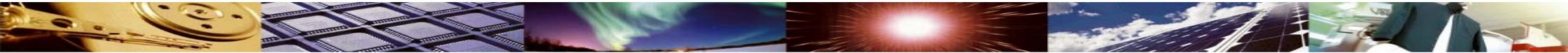
 **ワイエイシー株式会社**

(証券コード: 6298)

<http://www.yac.co.jp>

# Contents

1. **ご挨拶、中間決算の総括**  
..... 代表取締役 社長                      百瀬 武文
  
2. **2015年3月期中間連結決算の概要**  
..... 管理本部 経理部長                      古橋 博
  
3. **2015年3月期連結決算の見通し**  
..... 代表取締役 社長                      百瀬 武文
  
4. **新規事業のご紹介**  
..... 常務取締役                                  佐藤 康男  
..... 常務取締役                                  伊藤 利彦
  
5. **質疑応答**



# 1. ご挨拶、中間決算の総括

..... 代表取締役 社長 百瀬 武文

## ■ 前年同期比 減収・減益

- 受注残高は前年同期比  
3倍超を確保
- 電力インフラ関連事業が好調
- 新たに3事業を取り込み  
事業領域を拡大

下期に寄与



## 2. 2015年3月期中間連結決算の概要

…………… 管理本部 経理部長 古橋 博

# 2-1 事業結果



(単位:百万円)

	2014年3月期 第2四半期 連結累計期間	2015年3月期 第2四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
売上高	8,329	6,573	▲1,756	▲21.1%
営業利益 (営業利益率)	40 (0.5%)	▲279 (▲4.3%)	▲320	▲791.6%
経常利益	82	▲194	▲277	▲335.1%
当期純利益	25	▲169	▲194	▲763.3%
1株当たり 当期純利益(円)	2.86	▲18.98	▲21.84	—
研究開発費	93	133	40	43.7%
設備投資額	22	36	13	58.4%
減価償却実施額	123	138	14	11.7%

## 2-2 事業別売上金額



(単位:百万円)

	2014年3月期 第2四半期 連結累計期間	2015年3月期 第2四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
ハードディスク関連	298	320	22	7.4%
液晶関連	5,967	3,623	▲2,344	▲39.3%
半導体関連	125	155	30	24.0%
太陽電池関連	374	419	45	12.0%
FEL関連	0	0	0	—
精密熱処理関連	957	502	▲455	▲47.6%
工業用計器・ 制御通信関連	—	1,005	1,005	—
クリーニング関連	606	549	▲57	▲9.4%
合計	8,329	6,573	▲1,756	▲21.1%

# 2-3 事業別受注金額



(単位:百万円)

	2014年3月期 第2四半期 連結累計期間	2015年3月期 第2四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
ハードディスク関連	563	884	320	56.8%
液晶関連	1,792	1,673	▲119	▲6.6%
半導体関連	211	222	10	4.7%
太陽電池関連	361	2,119	1,758	487.0%
FEL関連	0	0	—	—
精密熱処理関連	1,366	1,130	▲236	▲17.3%
工業用計器・ 制御通信関連	—	1,890	1,890	—
クリーニング関連	606	549	▲57	▲9.4%
合計	4,901	8,467	3,566	72.8%

\* クリーニング関連は販売計画に基づいた見込み生産のため受注＝売上となります。

# 2-4 事業別受注残高



(単位:百万円)

	2014年3月期 第2四半期 連結累計期間	2015年3月期 第2四半期 連結累計期間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
ハードディスク関連	515	802	286	55.5%
液晶関連	1,593	1,509	▲84	▲5.3%
半導体関連	114	93	▲21	▲18.4%
太陽電池関連	230	1,912	1,682	731.3%
FEL関連	0	0	—	—
精密熱処理関連	525	3,517	2,991	569.7%
工業用計器・ 制御通信関連	—	1,572	1,572	—
クリーニング関連	0	0	—	—
合計	2,979	9,405	6,426	215.7%

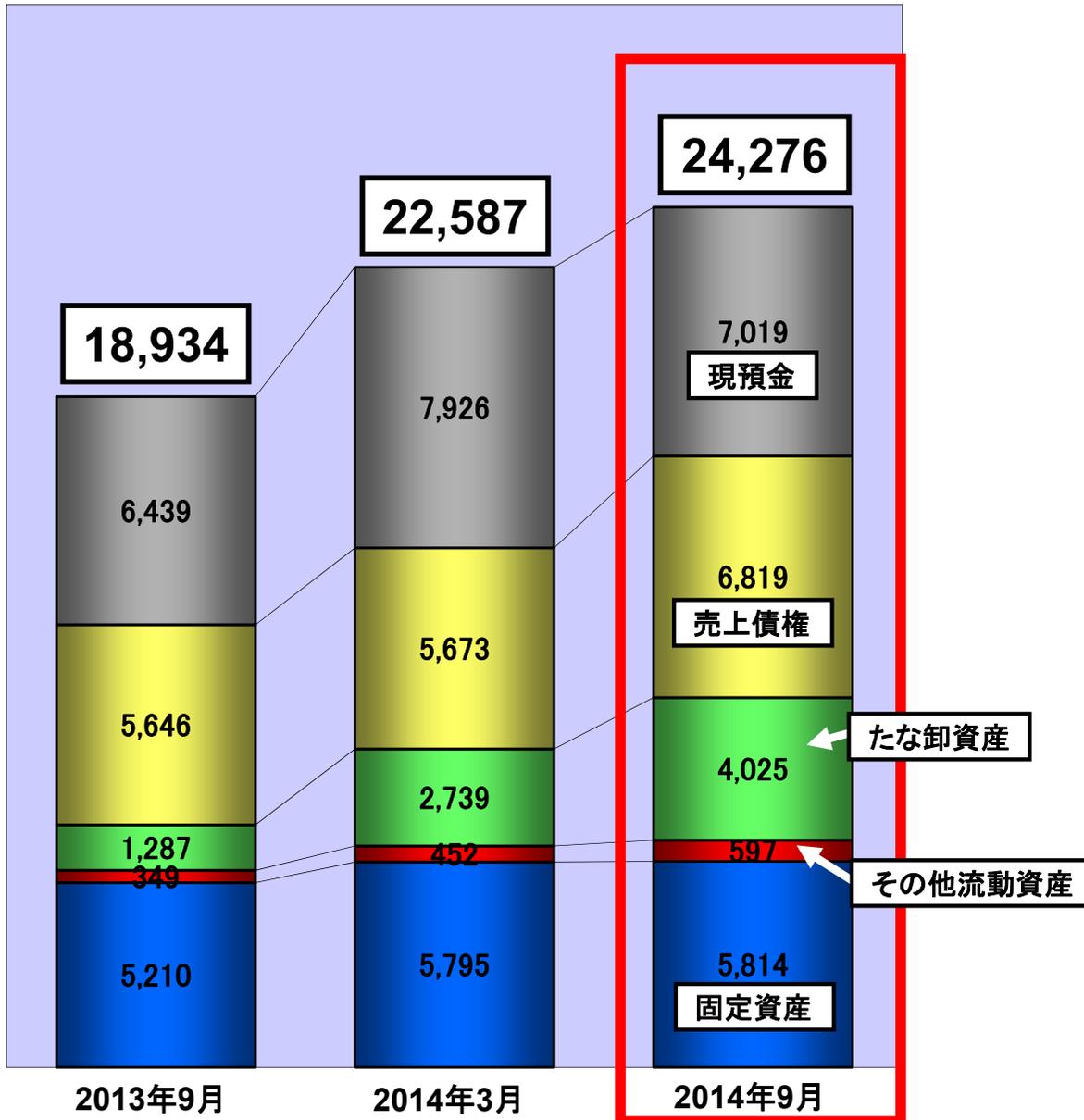
\* クリーニング関連は販売計画に基づいた見込み生産のため受注＝売上となります。

# 2-5 貸借対照表のレビュー



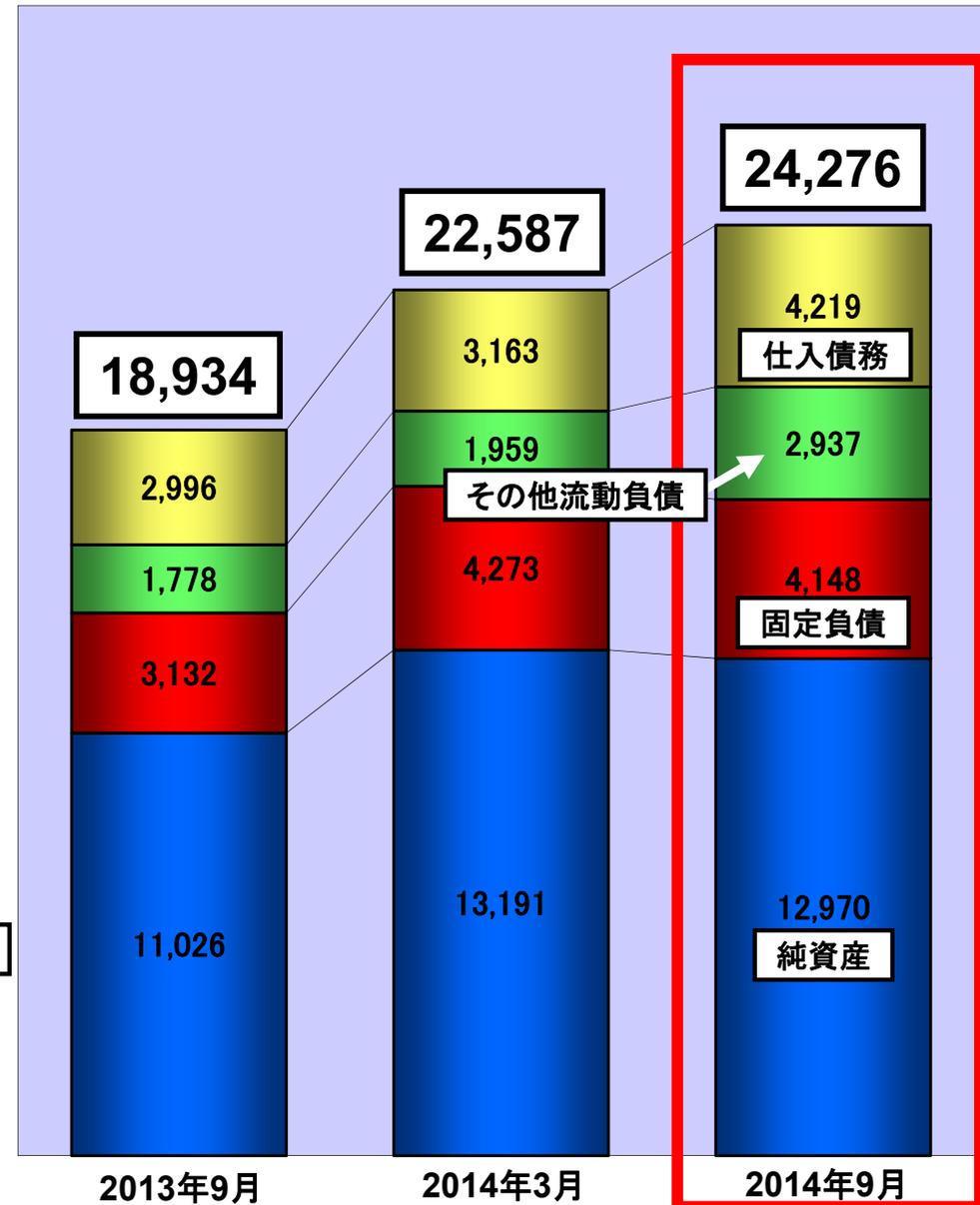
## 資産

(単位:百万円)



## 負債・純資産

(単位:百万円)



## 2-6 キャッシュフローのレビュー



(単位:百万円)

	2013年3月期 第2四半期 連結累計期間	2014年3月期 第2四半期 連結累計期間	2015年3月期 第2四半期 連結累計期間
営業活動によるCF	▲1,122	▲856	▲1,317
投資活動によるCF	▲65	▲830	▲44
財務活動によるCF	▲876	▲780	280
現金及び現金同等物の 期末残高	6,540	6,390	6,777



### **3. 2015年3月期連結決算の見通し**

**..... 代表取締役 社長 百瀬 武文**

- 液晶パネルは中国で大型投資継続  
⇒ IGZO向けの精密加熱装置とウエットエッチング装置を投入
- 電力インフラの投資意欲が旺盛  
⇒ 工業用計器・制御通信関連製品の販売拡大
- 半導体市場は順調  
⇒ ハンドラーに加え新製品を投入し販売拡大
- ハードディスクは高容量化が進む  
⇒ 次世代バニツシャーを投入
- クリーニング関連はグローバルに展開  
⇒ 中国では現地生産・現地販売を拡大  
リネン業界へ本格的に参入

■ 売 上 : 180億円  
■ 営業利益 : 7億円

- ◎客先の設備投資動向は増加基調
- ◎今期は下期に売上が集中しており、  
通期計画は当初見込み通り推移

# 3-3 2015年3月期連結見通し



(単位:百万円)

	2014年 3月期	2015年 3月期 (見込)	前年比 増減額 (見込)	前年比 増減率 (見込)
売上高	14,527	18,000	3,472	23.9%
営業利益	427	700	272	63.7%
経常利益	546	680	134	24.4%
当期純利益	2,229	430	▲1,799	▲80.7%
1株当たり 当期純利益(円)	250.00	48.21	—	—

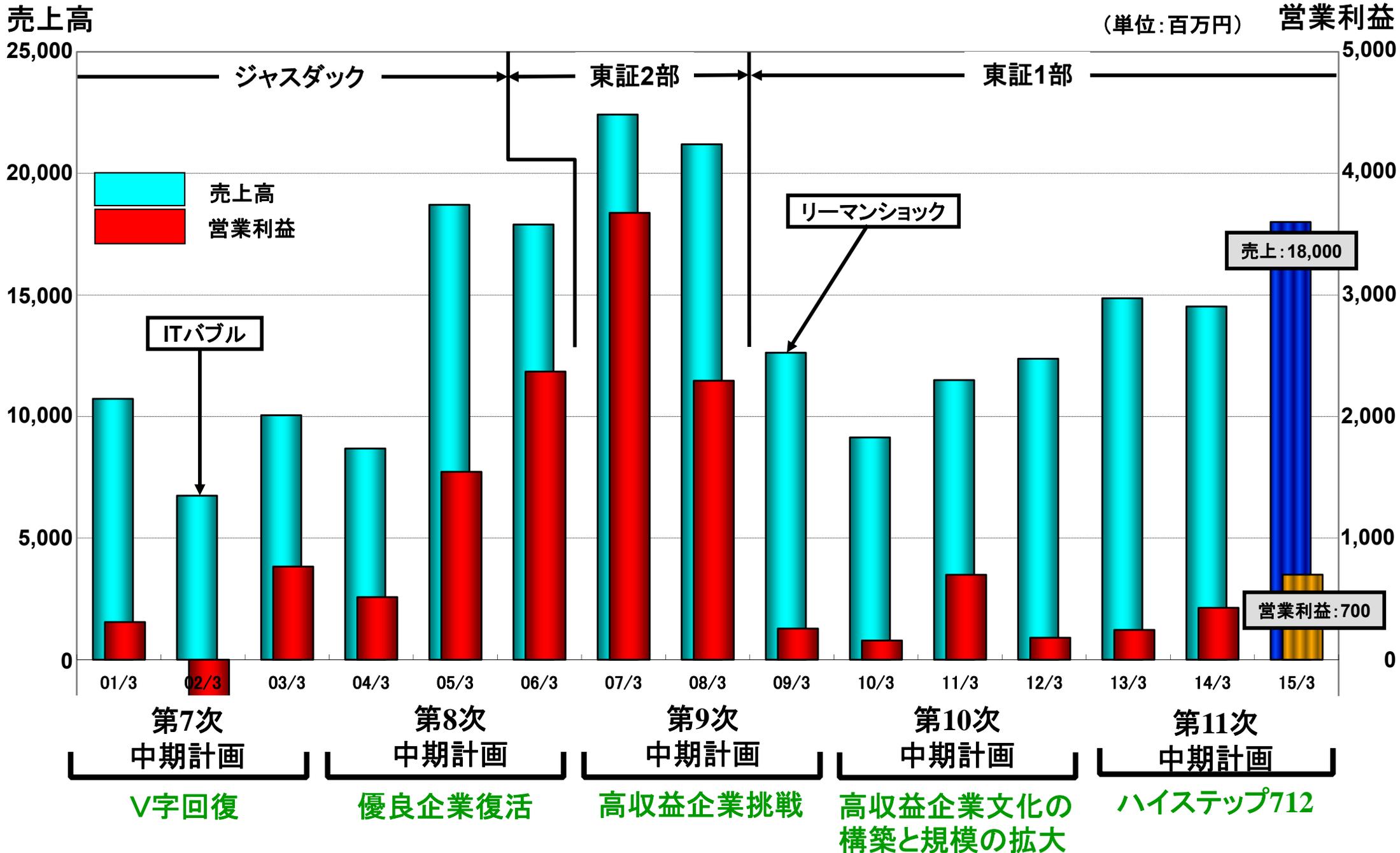
# 3-4 事業別売上見通し



(単位:百万円)

	2014年 3月期	2015年 3月期 (見込)	前年比 増減額 (見込)	前年比 増減率 (見込)
ハードディスク関連	864	1,800	936	108.3%
液晶関連	8,698	5,400	▲3,298	▲37.9%
半導体関連	667	800	133	19.9%
太陽電池関連	993	2,300	1,307	131.6%
FEL関連	2	0	▲2	▲100.0%
精密熱処理関連	923	3,400	2,477	268.3%
工業用計器・ 制御通信関連	952	2,800	1,848	194.1%
クリーニング関連	1,424	1,500	76	5.3%
合計	14,527	18,000	3,473	23.9%

# 3-5 過去の業績と2015年3月期見込



# 3-6 新規事業への取り組み



- 精密部品加工装置分野へ参入
- 半導体製造装置のラインアップ拡充
- レーザープロセス技術の応用
- FEL事業
- ロボット関連事業
- プラズマ技術の応用
- 医療・介護関連機器



## 4. 新規事業のご紹介

- ..... 常務取締役 佐藤 康男
- ..... 常務取締役 伊藤 利彦

### 新たに2社がグループ会社として加わり事業領域を拡大

株式会社ワイエイシイダステック(旧株式会社ダステック)は2002年(平成14年)に設立以来、精密素材の切断装置メーカーとしてお客様のニーズを実現する数多くの装置を提供しております。

#### 主要製品



#### 切断装置 (DAS110)

スマートフォンやハイブリッドカーなどの心臓部を支えるハイテク部品を構成する磁性材料、IC用セラミックパッケージ、光学用ガラス(レンズ、プリズム)、水晶、サファイヤなどの超精密難削素材を薄型外周刃で高精度に切断する、「これからの切断機」です。

#### バイオセルスライシングシステム

当社の特許「ワークの冷凍切削加工方法とワークの冷凍切削加工装置(特許4809086)」を用いて、極めて薄く多彩な形状の細胞サンプルを生体から生きた状態で切り出す凍結切断装置の開発に成功いたしました。再生医療、創薬開発、臨床医療に寄与すべく基礎開発を進めており、将来の大きな需要が見込まれています。



ワイエイシイフェトン株式会社(旧フェトン株式会社)は2002年(平成14年)に半導体プロセス技術とレーザー技術を融合したレーザープロセス装置メーカーとして設立以来、パワー半導体市場をメインに装置の開発、製造、販売をおこなっています。

パワー半導体は電気利用を最適に制御して損失を減らす省エネの鍵を握る重要なデバイスです。ハイブリッドカーの高い燃費や、太陽電池などの再生可能エネルギーによる発電を電力送電網に接続したスマートグリッドを実現するのもパワー半導体による高精度制御の賜物です。当社はこのパワー半導体製造特有のキーププロセスをレーザー技術により実現し量産装置として供給しております。

#### 主要製品

#### パワー半導体用レーザーアニール



#### SiC裏面電極金属層オーミック化専用装置



## トピックス **2**

TOPICS

### 半導体製造装置に新たなラインアップ

1994年(平成6年)に石英ガラス関連の半導体製造装置の製作を目的に設立されたオメガセミコン電子株式会社の製品が、半導体製造装置のラインアップに加わりました。

#### 主要製品



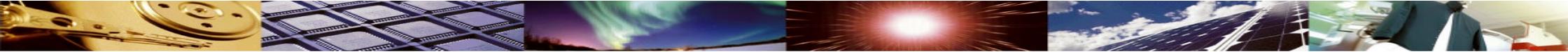
#### 1. IPAベーパー(イソプロピルアルコール蒸気)乾燥装置

半導体(LSI、MEMS、パワーデバイス)製造の洗浄工程における仕上げ乾燥工程においてIPA(イソプロピルアルコール)蒸気を利用したパーティクル(異物)付着をゼロとした乾燥装置。半導体メーカーおよび洗浄装置メーカーの多くに採用いただき歩留向上に貢献しています。



#### 2. 外部燃焼酸化装置 (清浄水蒸気発生装置)

高純度石英ガラス製の燃焼管内で水素を燃焼させて清浄な水蒸気を発生し、半導体製造におけるウェット酸化と呼ばれる酸化膜形成工程において重要な酸化剤として活用されています。



# 添付資料 ワイエイシイの概要

1. 基本情報
2. ワイエイシイの特徴
3. グローバルネットワーク
4. ワイエイシイグループの構成
5. 主力製品

# 1 基本情報



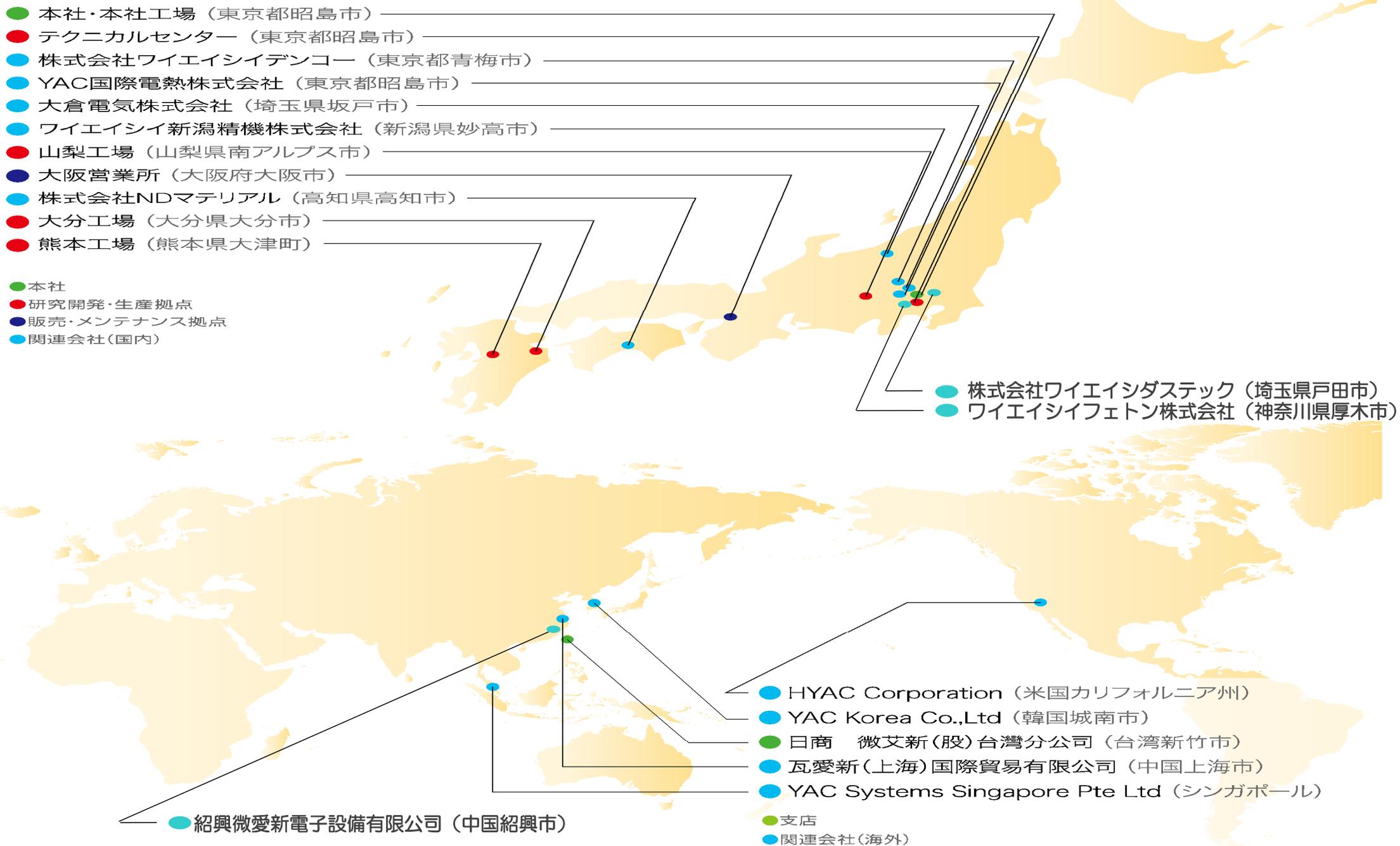
商号	ワイエイシイ株式会社
証券コード	6298 (東証1部)
設立	1973年(昭和48年)年5月
代表者	代表取締役社長 百瀬武文
事業所等	本社：東京都昭島市武蔵野3-11-10 営業所：大阪、昭島、新竹(台湾) 工場：昭島、山梨、熊本、大分
グループ会社	株式会社ワイエイシイデンコー(東京都青梅市) 大倉電気株式会社(埼玉県坂戸市) ワイエイシイ新潟精機株式会社(新潟県妙高市) 株式会社ワイエイシイダステック(埼玉県戸田市) ワイエイシイフェトン株式会社(神奈川県厚木市) YAC国際電熱株式会社(東京都昭島市) HYAC Corporation(米国カリフォルニア州) YAC Systems Singapore Pte Ltd(シンガポール) YAC KOREA CO.,LTD(韓国城南市) 瓦愛新(上海)国際貿易有限公司(中国上海市) 紹興微愛新電子設備有限公司(中国紹興市)
投資会社	株式会社NDマテリアル
資本金	2,756百万円
事業内容	産業用エレクトロニクス関連装置、クリーニング関連装置の 開発・設計・製造・販売
決算	3月31日

## 2 ワイエイシイの特徴

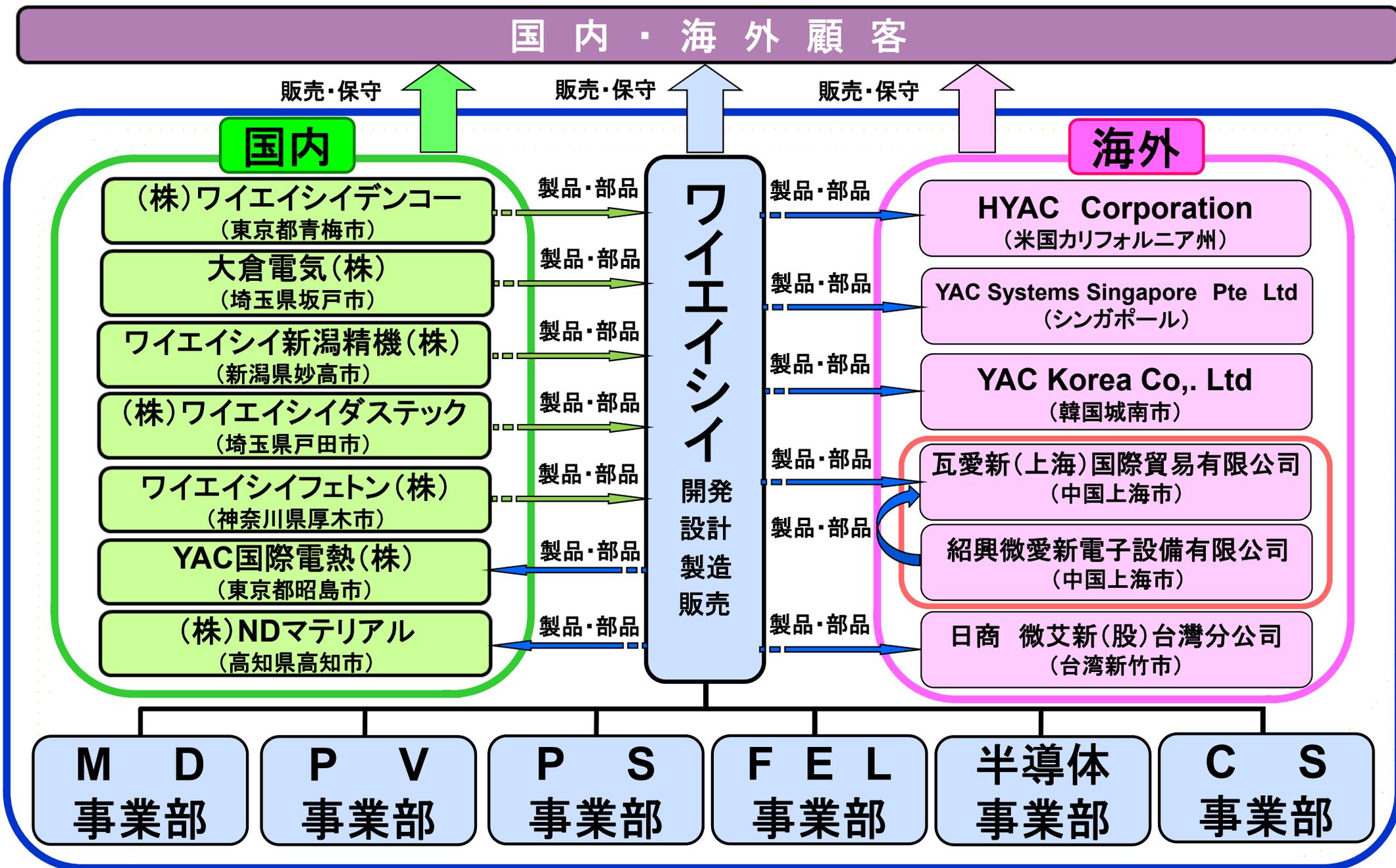


- 今期新たに2社を加えて 10分野の事業領域
- ファブレス
- M&A(過去13年間で12社の実績)
- アジアに注力した製・販のグローバル展開
- デバイス事業への参入
- 全員参加型経営(大討論会)

# 3 グローバルネットワーク



# 4 ワイエイシイグループの構成



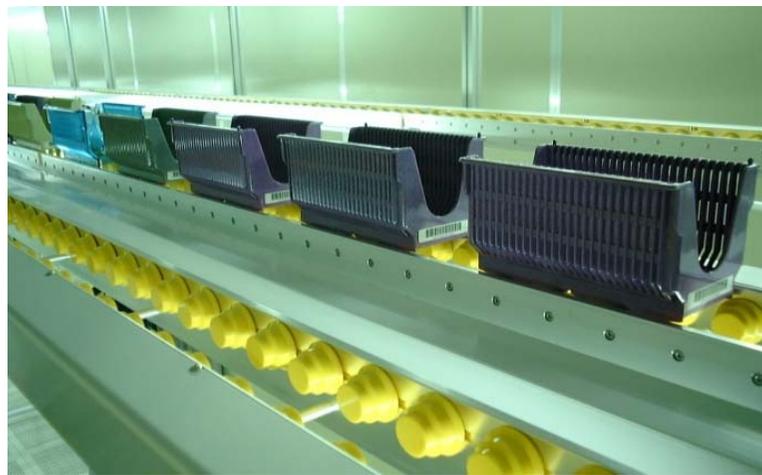
# 5-1 ハードディスク関連製品



バーニッシュ装置	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、表面のナノオーダーの微小突起を除去する精密研磨装置
ワイピング装置	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、バニッシュ工程の前後で、表面のパーティクルの除去及び潤滑財を表面に均一にする装置
UVキュア装置	基盤上の磁性膜面に潤滑剤(紫外線(UV)の波長に適合した潤滑剤が完成)を薄くなじませる装置
クリーンコンベア (HD工場向け)	モジュールの組み合わせで自由な搬送ライン設計が可能なローラー式コンベアAGV(自走型搬送ロボット)やOHT(天井架設型搬送装置)に比べ、搬送物をいつでも搬送ラインに投入することができ搬送効率が高い
クリーンコンベア (半導体工場向け、 太陽電池工場向け)	(同上)但し、半導体向けは搬送物が300mm用ウエハポット、太陽電池はガラス基板又は約5"ウエハーが入ったカセットで、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、耐衝撃性、高速搬送が要求される
クリーンコンベア (液晶工場向け)	(同上)但し、搬送物はパネルサイズに切りだされた基盤を搬送する、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、耐衝撃性、高速搬送が要求される



バーニッシュ装置



ハードディスク用クリーンコンベア



半導体用高速クリーンコンベア

# 5-2 液晶関連製品



<b>プラズマドライエッチング装置</b>	プラズマ技術を用いたドライエッチング装置 LTPS・OLEDといったスマートフォン向けの高精細加工をはじめとして、製造プロセスの効率化や省マスク技術、大型化などに最適
<b>アニール装置</b>	膜質の改質・改善をおこなうための熱処理装置 YHRシリーズは今後のLTPSスマートフォン・タブレットをターゲットとした高精細パネル製造に欠かせないRTA装置 LTPS高精細パネルの量産に適した装置性能を保持しており、スマートフォン・タブレットの更なる高性能化に寄与
<b>バレル式アッシング装置</b>	プラズマ技術を用いた国産初の半導体向けバッチ式アッシング装置 表面改質、滅菌分野など広範にわたり対応可能 PACKシリーズはポンプと発振器を専用ラックに収納可能な卓上タイプ



高密度プラズマドライエッチング装置



アニール装置(YHRシリーズ)



バレル式アッシング装置  
(PACKシリーズ)

# 5-3 半導体関連製品



<b>ロジック系IC用 テストハンドラー</b>	ICのパッケージング後の検査工程でテスターと接続して使用し、テスターからのテスト結果信号に基づきICを良品と不良品に自動選別する装置 必要に応じて精度の高い低温・高温(-55℃~155℃)下でのテストにも対応可能
<b>ポゴピン挿入機</b>	ポゴピンを使用したソケットの、ポゴピン交換を自動で行う省力化装置
<b>半導体製造装置 及び 関連部品洗浄装置</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・半導体向けWET処理装置・・・洗浄装置、レジスト剥離装置、ナイトライド装置</li> <li>・半導体向け周辺設備・・・石英管洗浄装置、各種保管庫、薬液供給ユニット</li> <li>・各種研究・開発用設備・・・手動処理装置、ドラフトチャンバー、スクラパー</li> <li>・関連部品洗浄装置・・・脱脂洗浄装置</li> </ul>



ロジック系ICテストハンドラー：C912 型  
低・常・高温測定が可能なマルチタイプ、開発用に最適



ポゴピン挿入機



ロジック系ICテストハンドラー：A/H343 型  
4個同時測定、常・高温タイプ、低振動、低発塵



石英管洗浄装置



手動処理装置



石英管保管庫



# 5-4 太陽電池関連製品



## 太陽電池(結晶・多結晶) 製造装置

- 単結晶・多結晶型太陽電池の全ライン(バッチおよびインライン方式)の製造装置
- ・テクスチャリング……………バッチ装置、インライン装置
  - ・拡散炉……………チューブ式装置
  - ・アイソレーション、PSGエッチング……………バッチ装置、インライン装置
  - ・配線形成……………新配線形成技術
  - ・その他関連装置……………手動処理装置



テクスチャリング装置



ISO/PSG装置



洗浄装置

# 5-5 FEL関連製品



## ナノダイヤモンド薄膜製造

金属等の材料の表面に、ナノダイヤモンド膜でコーティングしたエミッターを製作  
このエミッターを用いたフィールド・エミッション・ランプ(FEL)を試作

### FELの特徴

- ・従来の蛍光灯と異なり、水銀・鉛等の有害物質を使用しない
- ・LED(発光ダイオード)に比べ発熱量が少なく、冷却を必要としない(効率が良い)
- ・長寿命である
- ・色選択の自由度が高い(白色から紫外領域まで)



試作品



試作品



発光写真

# 5-6 精密熱処理関連製品



<p><b>フラットパネルディスプレイ(FPT)用 加熱装置</b></p>	<p>液晶ディスプレイ製造用加熱装置MB・MSシリーズ                  液晶・OLEDディスプレイ製造用加熱装置MTシリーズ                  液晶ディスプレイ製造用ホットプレート式加熱装置                  液晶・OLEDディスプレイ製造用減圧乾燥装置、液晶用ウォーキングビーム式連続焼成炉</p>
<p><b>太陽電池関連装置</b></p>	<p>縦型ガラス基板加熱装置、薄膜太陽電池EVA架橋炉、縦型多段式拡散炉                  ウォーキングビーム式連続乾燥炉</p>
<p><b>電子部品加熱装置</b></p>	<p>メッシュベルト搬送式連続炉(マッフル)、メッシュベルト搬送式連続炉(マッフルレス)                  ローラーハースキルン、電子部品用各種テスト炉</p>
<p><b>ヒーター及び関連機器</b></p>	<p>ラジアントパットヒーター(PD・GPDシリーズ)                  インフラユニ(BD・SGシリーズ)                  インフラユニットヒーター(PS・PU・PH・PMシリーズ) <span style="float: right;">各種ヒーター</span></p>
<p><b>自動車部品用加熱装置</b></p>	<p>自動車関連工業加熱装置(ハイテンション鋼板用)、金型予熱装置</p>



IGZO、OLEDアニール装置



金型予熱装置



ローラーハース式加熱炉



自動車関連ハイテンション鋼板

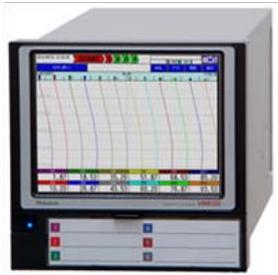


多段式加熱炉

# 5-7 工業用計器・制御通信関連製品



<b>工業計器</b>	計測と制御も技術をコアに原子力発電所採用の記録計・データロガー、精密温度制御を中心とした制御機器、水質・圧力・水位などのセンサー機器まで、幅広い産業分野のオートメーション化に貢献
<b>制御通信</b>	電力、ガス、上下水道、鉄道をはじめとした大規模でかつ広域なネットワークシステムを支えるため、情報伝送装置、遠方監視制御装置、データ処理装置のシステム製品から高精度電力計測機器および高信頼性モデムを提供し、社会インフラの構築に貢献
<b>半導体</b>	工業計器メーカーとして培った計測・制御・センシングの固有技術を生かし、ユーザーニーズにきめ細かく応えられる縦型・横型拡散炉、拡散炉管理システムおよび他社製を含めた拡散炉のリニューアル対応機器を提供



ペーパーレスレコーダ



デジタル指示調節計  
プログラム調節計



ハイブリッドレコーダ



圧力伝送器

## 工業計器製品



IP対応型情報伝送制御装置



IP対応型  
接点情報入出力装置



高精度トランスデューサ

## 制御通信製品



縦型熱処理炉

## 半導体製品

# 5-8 精密切断関連製品



<p><b>フルオートマテック スライサー</b></p>	<p>厚いデバイスや複合デバイスのような切りにくいデバイスを切断することを目的とするフルオートメーションのスライサーです。従来機では多段カット(ステップカット等)していたデバイスも、1パスでの切断を実現しました。 適用ワーク : サファイアデバイス、ガラス、セラミックを多く含む複合デバイス、CSP、QFP、QFN、そのほかのパッケージ、金属材料、セラミックス。</p>
<p><b>スライシング ダイシングマシン</b></p>	<p>自動θ軸・自動アライメント機能を有し、深切(厚物)をマルチブレードにて高精度に切断が可能です。コンパクトで安全性にも優れ、従来機との違いを実感いただける、「これからの切断機」です。</p>
<p><b>フルオートマテック コアドリルマシン</b></p>	<p>コアドリルマシンとは、円筒形磁石(コアドリル)にて丸形やドーナツ形状に切り抜くことが出来る装置です。ガラス・水晶などを丸型に切断加工できます。自動搬送・自動アライメント機能を搭載し、全自動化対応装置です。</p>
<p><b>リセール事業</b></p>	<p>中古の切断装置、ダイサー、半導体製造装置の買い取り、再生・販売を行っています。</p> <div data-bbox="517 624 2168 1047"> <p>ダイサー再生・販売ステーションのしくみ (全て自社にてご提供)</p> <pre> graph TD     subgraph Buy [買います!]         A[査定ご依頼 (TEL・メール) まずはお気軽に!] --&gt; B[概要確認 (書類・TEL) プロの目で幅広く判断]         B --&gt; C[無料 出張見積り 買い取り 梱包・手続きは全て当社にて]         C --&gt; D[自社工場で再生 ・リファーマビッシュ ・動作確認]     end     subgraph Sell [売ります!]         D --&gt; E[お問い合わせ(TEL・メール) ご説明 お問い合わせだけでもOK!]         E --&gt; F[実機確認 (ご来社or動画)]         F --&gt; G[ご購入 OPTION 出張据付]         G --&gt; A     end     </pre> </div>



DFS110

フルオートマテックスライサー



DAS110

スライシング/ダイシングマシン  
＜凍結固定切断仕様＞



DAR810

全自動コアドリルマシン

# 5-9 レーザープロセス関連製品



<b>レーザーアニーラ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○IGBT・パワー半導体素子用レーザーアニーラ<ul style="list-style-type: none"><li>・裏面のみの熱処理により、表面に熱ダメージを与えません</li><li>・2波長レーザーアニールにより、アニール深さを1~10<math>\mu</math>mの範囲でコントロールが可能</li><li>・連続発振レーザーと、回転テーブルの組合せにより、高スループットを実現</li></ul></li></ul>
<b>マイクロマルチレーザードリラ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○超微細孔加工 : 15~50<math>\mu</math>m径の超微細穴を加工</li><li>○多数穴超高速加工(高スループット) : 最大100mm口内最大約100万個を30~500secで加工(最速0.1ms以下/穴)</li><li>○高精度加工 : 穴位置精度<math>&lt;\pm 0.5\mu</math>m、穴径精度<math>&lt;\pm 0.5\mu</math>m</li><li>○長期安定・調整容易(少ダウンタイム) :<ul style="list-style-type: none"><li>・レーザープロファイルの変動による影響を受けない</li><li>・シンプルな光学系により、調整が容易</li></ul></li></ul>
<b>レーザーエッチャ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○小ロット生産用レーザー薄膜エッチングシステム : 小ロット生産・研究開発向けの太陽電池パネルのa-Si、ディスプレイの金属薄膜・透明伝導電膜などのパターンニングに最適</li><li>○大面積生産用レーザー薄膜エッチングシステム : 大面積太陽電池パネルのa-Siや透明導電膜のパターンニングに最適</li></ul>



IGBT・パワー半導体素子用  
レーザーアニーラ



マイクロマルチレーザードリラ



レーザー薄膜エッチングシステム

# 5-10 クリーニング関連製品



<b>ワイシャツプレス機</b>	ワイシャツを熱板、熱風で仕上げる装置 襟とカフス、タックと袖、およびボディを3台の装置で仕上げる高速タイプはワイシャツプレス機の定番商品 タック、袖、ボディを一体で仕上げるボディースリーブタイプもある
<b>ウール仕上機</b>	ジャケット、ブラウス、パンツ、スカートなどを仕上げる装置
<b>自動包装機</b>	クリーニング完了後の衣類を自動で包装する装置 ハンガーにかけたまま包装する立体タイプと、畳んだ状態で包装する平面タイプがある
<b>アパレル関連機械</b>	洋服の生産工程、縮絨機(生地を蒸気で安定化させる)、芯地・接着機(裁断後の生地を張り合わせる) プレス仕上げ機(完成商品のシワを取り成型する)等、各種装置をラインナップ



全自動包装機 (立体タイプ)



ワイシャツ用ボディースリーブプレス機  
(ダブルタイプ)



ジャケット・ブラウス仕上機



パンツ仕上機



さあ今日も、

ときめきと感動の日々であれ！

くまがや先端技術企業



# ワイエイシー株式会社

## 数字の処理について

記載されている金額は百万円未満を切り捨て、その比率については小数第2位を四捨五入しています。

業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予測値と異なる可能性があります。

なお、第1四半期連結会計期間より在外子会社の収益および費用の換算方法の変更を行ったため、前年度数値は遡及適用後の数値に基づき算出しております。